



SUOMI—FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN
[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus-Patentansökan 871333
(51) Kv.lk.4/Int.cl.4 A 01 G 7/00
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 26.03.87
(23) Alkupäivä-Löpdag
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 27.09.88
(86) Kv. hakemus-Int.ansökan
(30) Etuoikeus-Prioritet

(71) Hakijat/Sökande: 1. Kemira Oy, H:ki; Espoon Tutkimuskeskus, PL 44, 02271 Espoo, Suomi 2. Enso-Gutzeit Oy, PL 309, 00101 Helsinki, Suomi

(72) Keksijät/Uppfinnare: 1. Törmälä, Timo 2. Jokinen, Kari 3. Jonasson, Donald 4. Manneri, Esa 5. Puska, Reetta

(74) Asiamies/Ombud: Berggren

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Menetelmä kasvimateriaalin leikkaamiseksi käyttäen laser-sädettä. Förfarande för att skära växtmaterial genom att använda laser-stråle.

(57) Tiivistelmä

Keksintö koskee menetelmää kasvimateriaalin leikkaamiseksi kasvien lisäämistä, erityisesti mikrolisäystä varten, jossa menetelmässä leikkaaminen suoritetaan käyttäen laser-sädettä.

(57) Sammandrag

Uppfinningen avser ett förfarande för att skära växtmaterial för tillväxtning, särskild för mikrotillväxt, av växter, vid vilket förfarande skärningen utförs med laser-stråle.